



# Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN23490X

Issue Date: 27 Aug 2020

<b>Title of Change:</b>	Panasonic Mold Compound Qualification for SOIC 8 and SOIC 14 products assembled with Cu wire in ON Semiconductor Philippines, Inc. (OSPI)	
<b>Proposed First Ship date:</b>	03 Jan 2021 or earlier if approved by customer	
<b>Contact Information:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <a href="mailto:Dennis.Samaniego@onsemi.com">Dennis.Samaniego@onsemi.com</a>	
<b>PCN Samples Contact:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <a href="mailto:PCN.samples@onsemi.com">PCN.samples@onsemi.com</a> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
<b>Type of Notification:</b>	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a>	
<b>Marking of Parts/ Traceability of Change:</b>	The affected products will be identified with date code	
<b>Change Category:</b>	Assembly Change	
<b>Change Sub-Category(s):</b>	Material Change	
<b>Sites Affected:</b>		
<b>ON Semiconductor Sites</b>	<b>External Foundry/Subcon Sites</b>	
ON Semiconductor Carmona, Philippines	None	
<b>Description and Purpose:</b>		
<p>ON Semiconductor is notifying of the intent to change from Sumitomo Bakelite G600 to Panasonic CV8213A-D mold compound.</p> <p>This change will affect products which are assembled with copper wire in SOIC 8 and 14 lead packages in OSPI location.</p> <p>There are no changes to product design, electrical specifications, or physical dimensions as a result of this notification.</p> <p>All products will continue to meet or exceed ON Semiconductor reliability standards.</p>		
	<b>Before Change Description</b>	<b>After Change Description</b>
Mold Compound	SUMITOMO BAKELITE G600	PANASONIC CV8213A-D
There is no product marking change as a result of this change.		

**Qualification Plan:**

Device Name : LM393DR2G

Package : SOIC 8

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, bias at 1.2X Nominal (not to exceed Max rated)	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -65 °C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1@ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec	
SAT	As outlined in MSB17722C	12MSB17722C	
DPA	AEC-Q101-004 Section 4	Post TC only	
CDPA TCDT	AEC Q101, rev D, Test 7A (alt)	Post 500cyc TC (+PC)	
CDPA WP		Post 10008hr HTSL, TC	
WBS	AEC-Q100-001	Per Assy spec	
WBP	Mil-Std-883 Method 2011	Per Assy spec	

Device Name : LM2902DR2G

Package : SOIC 14

Test	Specification	Condition	Interval
ELFR	AECQ100-008	Ta=125°C, bias at 1.2X Nominal (not to exceed Max rated)	48 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1@ 260°C	
TC	JESD22-A104	Ta= -65 °C to +150°C	1000 cyc
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec	
SAT	As outlined in MSB17722C	12MSB17722C	
CDPA WP		Post 10008hr HTSL, TC	
CDPA SEM		Post 500cyc TC Only	
WBS	AEC-Q100-001	Per Assy spec	
WBP	Mil-Std-883 Method 2011	Per Assy spec	

**Estimated date for qualification completion: 23 October 2020**

**List of Affected Parts:**

**Note:** Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
LM2901DR2G	LM2902DR2G
LM2902DR2G	LM2902DR2G
LM324DR2G	LM2902DR2G
LM339DR2G	LM2902DR2G
LM2903DR2G	LM393DR2G
LM2904DR2G	LM393DR2G
LM358DR2G	LM393DR2G
LM393DR2G	LM393DR2G

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

*Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



## 初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23490X

発行日: 27 Aug 2020

変更件名:	オン・セミコンダクター フィリピン (OSPI) における銅ワイヤで組み立てられる SOIC 8 および SOIC 14 製品に対してパナソニック製モールドコンパウンドを認定	
初回出荷予定日:	03 Jan 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <a href="mailto:Dennis.Samaniego@onsemi.com">Dennis.Samaniego@onsemi.com</a> にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <a href="mailto:PCN.Samples@onsemi.com">PCN.Samples@onsemi.com</a> にお問い合わせください。サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、 <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a> にお問い合わせください。	
部品のマーキング/変更のトレサビリティ:	影響を受ける製品は日付コードで識別されます。	
変更カテゴリ:	組立の変更	
変更サブカテゴリ:	材料の変更	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
ON Semiconductor Carmona, Philippines	なし	
説明および目的:	<p>オン・セミコンダクターは、モールドコンパウンドを住友ベークライト製 G600 からパナソニック製 CV8213A-D に変更する意向があることをお知らせします。</p> <p>この変更は、OSPI 拠点の SOIC 8 および SOIC 14 リードパッケージにおいて銅ワイヤで組み立てられる製品に適用します。</p> <p>今回の通知に伴う製品設計、電気的特性、または物理的寸法の変更はありません。</p> <p>すべての製品の信頼性は引き続きオン・セミコンダクターの基準以上となります。</p>	
	変更前の表記	変更後の表記
モールドコンパウンド	SUMITOMO BAKELITE G600	PANASONIC CV8213A-D
今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。		



## 認定計画:

デバイス名: LM393DR2G  
RMS: SOIC 8

テスト	規格	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, bias at 1.2X Nominal (not to exceed Max rated)	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -65 °C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1@ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec	
SAT	As outlined in MSB17722C	12MSB17722C	
DPA	AEC-Q101-004 Section 4	Post TC only	
CDPA TCDT	AEC Q101, rev D, Test 7A (alt)	Post 500cyc TC (+PC)	
CDPA WP		Post 10008hr HTSL, TC	
WBS	AEC-Q100-001	Per Assy spec	
WBP	Mil-Std-883 Method 2011	Per Assy spec	

デバイス名: LM2902DR2G  
RMS: SOIC 14

テスト	規格	条件	間隔
ELFR	AECQ100-008	Ta=125°C, bias at 1.2X Nominal (not to exceed Max rated)	48 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1@ 260°C	
TC	JESD22-A104	Ta= -65 °C to +150°C	1000 cyc
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec	
SAT	As outlined in MSB17722C	12MSB17722C	
CDPA WP		Post 10008hr HTSL, TC	
CDPA SEM		Post 500cyc TC Only	
WBS	AEC-Q100-001	Per Assy spec	
WBP	Mil-Std-883 Method 2011	Per Assy spec	

認定完了予定日: 23 October 2020



## 初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23490X

発行日 : 27 Aug 2020

## 影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ビークル
LM2901DR2G	LM2902DR2G
LM2902DR2G	LM2902DR2G
LM324DR2G	LM2902DR2G
LM339DR2G	LM2902DR2G
LM2903DR2G	LM393DR2G
LM2904DR2G	LM393DR2G
LM358DR2G	LM393DR2G
LM393DR2G	LM393DR2G